

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION

中芯國際集成電路製造有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0981)

中芯國際截至二零一零年六月三十日止三個月業績公佈

- 二零一零年第二季的總銷售額，由二零一零年第一季的三億五千一百七十萬元上升 8.4% 至三億八千一百一十萬元，與二零零九年第二季相比上升 42.5%。
- 二零一零年第二季的毛利率由二零一零年第一季的 14.6% 改善至 15.6% 主要是由於產能使用率提高所致。
- 二零一零年第二季來自於經營活動的現金淨額由二零一零年第一季的一億五千三百三十萬元增加至一億六千七百五十萬元。
- 二零一零年第二季普通股持有人應佔盈利為九千六百萬元；相對二零一零年第一季虧損一億八千一百九十萬元，是由於股權及認購權證授予協定的公平價值一億五百九十萬的改變。
- 每股美國預托股股份淨盈利(攤薄)為 0.20 元。

以下為本公司於二零一零年八月十日就截至二零一零年六月三十日止三個月的未經審核業績公佈全文。

所有貨幣以美元列賬，除非特別指明。

報告內的財務報表數額按美國公認會計原則厘定。

中國上海 — 2010 年 8 月 10 日 — 國際主要半導體代工製造商中芯國際集成電路製造有限公司(紐約交易所：SMI；香港聯交所：981)(「中芯」或「本公司」)於今日公佈截至二零一零年六月三十日止三個月的綜合經營業績。

二零一零年第二季概要

- 二零一零年第二季的總銷售額，由二零一零年第一季的三億五千一百七十萬元上升 8.4% 至三億八千一百一十萬元，與二零零九年第二季相比上升 42.5%。
- 二零一零年第二季的毛利率由二零一零年第一季的 14.6% 改善至 15.6% 主要是由於產能使用率提高所致。
- 二零一零年第二季來自於經營活動的現金淨額由二零一零年第一季的一億五千三百三十萬元增加至一億六千七百五十萬元。
- 二零一零年第二季普通股持有人應佔盈利為九千六百萬元；相對二零一零年第一季虧損一億八千一百九十萬元，是由於股權及認購權證授予協定的公平價值一億五百九十萬的改變。
- 每股美國預托股股份淨盈利(攤薄)為 0.20 元。

二零一零年第三季指引

以下聲明為前瞻性陳述，此陳述基於目前的期望並涵蓋風險和不確定性，部分已於之後的安全港聲明中闡明。

- 二零一零年第三季收入預期增加 4% 至 6%。
- 毛利率預期達到 20% 至 22%。
- 預期經營開支去除匯兌損益介乎於八千萬至八千四百萬美元之間。
- 2010 年度預期資本支出介乎於七億至七億五千萬美元之間。

在評論季度業績時，中芯國際總裁兼首席執行官王寧國博士表示：「在 2010 年的第二季度，我們見證了整體的增長並相信我們正走向持續盈利。擁有全世界最高的經濟增長率，中國市場在整體的晶圓需求上不斷增長並在中芯邁向未來成功中扮演日漸重要的角色。在中國市場的無廠房半導體公司逐步成熟的驅動下，我們的中國市場銷售額季對季增長了 27.4%。鑒於中國市場的無廠房半導體公司日益強大，中芯正抓住這個機遇並把自己定位於國內無廠房半導體公司認可的首選代工廠。北美地區的客戶繼續貢獻了我們過半的收入，我們積極地通過提升營運，技術和服務來建立與客戶的夥伴關係。

從技術角度來看，我們的 65 納米製程穩定同時產能也持續增加，第二季對第一季付運超過雙倍增長並可望在第三季再次翻倍。在 45/40 納米研發進展順利並預計在年底完成製程開發。我們持續並積極扭轉公司局面，以卓越的服務滿足客戶需求以維持競爭力，平衡擴充規模以確保可持續營利。

本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09(1) 條規定的披露責任於二零一零年八月十日作出本公佈。

電話會議／網上業績公佈詳情

日期：二零一零年八月十一日，星期三

時間：上海時間上午八時三十分

撥號及登入密碼：美國 1-617-614-3672(密碼：SMIC)或香港 852-3002-1672(密碼：SMIC)

二零一零年第一季業績公佈網上直播可於 www.smics.com 網站「投資者關係」一欄收聽。中芯網站在網上廣播後為期十二個月提供網上廣播錄音版本連同本新聞發佈的軟拷貝。

關於中芯國際

中芯國際集成電路製造有限公司(“中芯國際”，紐約證交所股票代碼:SMI，香港聯合交易所股票代碼: 981)，是世界領先的集成電路晶圓代工企業之一，也是中國內地規模最大、技術最先進的集成電路晶圓代工企業。中芯國際向全球客戶提供 0.35 微米到 45/40 納米晶圓代工與技術服務。中芯國際總部位於上海，在上海建有一座 300mm 晶圓廠和三座 200mm 晶圓廠。在北京建有兩座 300mm 晶圓廠，在天津建有一座 200mm 晶圓廠，在深圳有一座 200mm 晶圓廠在興建中，在成都擁有一座封裝測試廠。中芯國際還在美國、歐洲、日本提供客戶服務和設立營銷辦事處，同時在香港設立了代表處。此外，中芯代成都成芯半導體製造有限公司經營管理一座 200mm 晶圓廠，也代武漢新芯集成電路製造有限公司經營管理一座 300mm 晶圓廠。

詳細資訊請參考中芯國際網站 <http://www.smics.com>

安全港聲明

(根據1995 私人有價證券訴訟改革法案)

本次新聞發佈可能載有(除歷史資料外)依據1995 美國私人有價證券訴訟改革法案的“安全港”條文所界定的「前瞻性陳述」。該等前瞻性陳述，包括我們相信我們即將盈利和“2010年第三季度指引”等聲明乃根據中芯對未來事件的現行假設、期望及預測而作出。中芯使用「相信」、「預期」、「打算」、「估計」、「期望」、「預測」、「有信心」或類似的用語來標識前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性聲明都包含這些用語。該等前瞻性陳述乃反映中芯高級管理層根據最佳判斷作出的估計，存在重大已知及未知風險、不確定性，以及其他可能導致中芯實際業績、財政狀況或經營結果與前瞻性陳述所載資料存在重大差異的因素，包括(但不限於)與半導體行業周期及市場狀況有關的風險、全球經濟衰退及其對中國經濟的影響、激烈競爭、中芯客戶能否及時接收晶圓產品、能否及時引進新技術、中芯抓住在中國發展機遇的能力、中芯於加強全面產品組合的能力、半導體代工服務供需情況、行業產能過剩、設備、零件及原材料短缺、能否有足夠的產能，終端市場的財政穩定、中芯股價將來的變動和將來潛在的訴訟和索償。

投資者應考慮中芯呈交予美國證券交易委員會(「證交會」)的文件資料，包括其於二零一零年六月二十九日以 20-F 表格形式呈交給證交會的年報，特別是在「風險因素」和「管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析」部分，並中芯不時向證交會(包括以 6-K 表格形式)，或香港交易所(「港交所」)呈交的其他文件。其他未知或不可預測的因素也可能對中芯的未來結果，業績或成就產生重大不利影響。鑒於這些風險，不確定性，假設及因素，本次新聞發佈中討論的前瞻性事件可能不會發生。請閣下審慎不要過分依賴這些前瞻性聲明，因其只於聲明當日有效，如果沒有標明聲明的日期，就截至本新聞發佈之日。除法律有所規定以外，中芯概不負責因新資料、未來事件或其他原因引起的任何情況，亦不擬更新任何前瞻性陳述。

二零一零年第二季經營業績概要：

以千美元為單位(每股盈利和百分比除外)

	二零一零年 第二季度	二零一零年 第一季度	季度比較	二零零九年 第二季度	年度比較
銷售收入	381,142	351,724	8.4%	267,422	42.5%
銷售成本	321,755	300,270	7.2%	280,319	14.8%
毛利(虧損)	59,387	51,454	15.4%	(12,897)	-
經營開支	71,507	79,496	-10.0%	81,606	-12.4%
經營虧損	(12,120)	(28,042)	-56.8%	(94,503)	-87.2%
其他費用，淨額	101,812	(155,567)	-	(5,802)	-
所得稅利益	6,466	2,374	172.4%	2,880	124.5%
稅後淨盈利/(虧損)	96,158	(181,235)	-	(97,425)	-
應佔聯營公司盈利/(虧損)	141	(455)	-	(482)	-
淨盈利/(虧損)	96,299	(181,690)	-	(97,907)	-
非控制權益持有人利息	(262)	(259)	1.2%	(262)	0.0%
普通股持有人應佔盈利/(虧損)	96,037	(181,949)	-	(98,169)	-
毛利率	15.6%	14.6%		-4.8%	
經營利潤率	-3.2%	-8.0%		-35.3%	
每股普通股股份淨盈利/(虧損) — 基本 ⁽¹⁾	0.00	(0.01)		(0.00)	
每股美國預托股股份淨盈利/(虧損) — 基本	0.21	(0.41)		(0.22)	
每股普通股股份淨盈利/(虧損) — 攤薄 ⁽¹⁾	0.00	(0.01)		(0.00)	
每股美國預托股股份淨盈利/(虧損) — 攤薄	0.20	(0.41)		(0.22)	
付運晶圓(約當 8 吋) ⁽²⁾	496,766	455,010	9.2%	341,261	45.6%
產能使用率	94.3%	92.1%		75.4%	

附注：

(1) 基於二零一零年第二季加權平均普通股 224 億 8 千萬股(基本)及 245 億 3 千 4 百萬股(攤薄)，二零一零年第一季 223 億 9 千 7 百萬股(基本)及 223 億 9 千 7 百萬股(攤薄)，二零零九年第二季 223 億 5 千 2 百萬股(基本)及 223 億 5 千 2 百萬股(攤薄)。

(2) 包括銅製程

- 二零一零年第二季總銷售額由二零一零年第一季的 3 億 5 千 1 百 70 萬元上升至 3 億 8 千 1 百 10 萬元，錄得季度升幅 8.4%，是由於晶圓付運上升 9.2% 所致。付運上升主要源自於我們對所管理的晶圓代工工廠武漢新芯和成都成芯銷售模式的改變。在改變了的模式下，客戶直接與中芯國際簽訂晶圓代工合同，然後訂單被外包至新芯和成芯。這一模式導致了銷售額的入賬從備金提成到轉售。新芯和成芯的銷售額共計 1 千 7 百 70 萬元，占總銷售額的 4.6%。
- 二零一零年第二季的銷售成本與二零一零年第一季的 3 億零 30 萬元相比，上升 7.2% 至 3 億 2 千 1 百 80 萬元。
- 二零一零年第二季的毛利為 5 千 9 百 40 萬元，相對二零一零年第一季的 5 千 1 百 50 萬元及二零零九年第二季的負 1 億 2 千 9 百萬元。
- 二零一零年第二季的毛利率由二零一零年第一季的 14.6% 改善至 15.6%，主要是由於產能使用率提高所致。
- 二零一零年第二季的總經營開支與二零一零年第一季的 7 千 9 百 50 萬元相比，錄得季度降幅 10.0% 至 7 千 1 百 50 萬元。季度降幅由於二零一零年第一季發生長期資產減值損失和本季內的一般及行政費用減少所致。
- 二零一零年第二季的研究及開發費用與二零一零年第一季的 4 千 3 百 60 萬元相比，錄得季度降幅 0.6% 至 4 千 3 百 30 萬元。
- 二零一零年第二季的一般及行政費用與二零一零年第一季的 1 千 7 百 60 萬元相比下降至 1 千 5 百萬元。
- 二零一零年第二季的銷售和市場推廣費用由二零一零年第一季的 600 萬元上升至 700 萬元，錄得季度升幅 16.1%。

收入分析

銷售分析			
以應用分類	二零一零年 第二季度	二零一零年 第一季度	二零零九年 第二季度
電腦	3.4%	4.3%	4.3%
通訊	47.1%	51.5%	53.5%
消費	42.2%	37.0%	36.1%
其他	7.3%	7.2%	6.1%
以服務分類	二零一零年 第二季度	二零一零年 第一季度	二零零九年 第二季度
邏輯 ⁽¹⁾	90.6%	90.3%	90.9%
記憶	1.7%	2.7%	2.7%
光罩製造，晶圓測試及其它	7.7%	7.0%	6.4%
以客戶類別分類	二零一零年 第二季度	二零一零年 第一季度	二零零九年 第二季度
無廠房半導體公司	66.1%	66.4%	65.1%
集成裝置製造商	16.1%	17.0%	18.2%
系統公司及其它	17.8%	16.6%	16.7%
以地區分類	二零一零年 第二季度	二零一零年 第一季度	二零零九年 第二季度
北美洲	52.2%	58.9%	61.4%
中國 ⁽²⁾	28.7%	24.4%	19.0%
歐亞 ⁽³⁾	19.1%	16.7%	19.6%
晶圓收入分析			
各技術佔晶圓銷售額的百分比	二零一零年 第二季度	二零一零年 第一季度	二零零九年 第二季度
90 納米及以下	23.6%	20.3%	16.7%
0.13 微米	32.2%	35.5%	29.7%
0.15 微米	1.8%	1.5%	1.5%
0.18 微米	26.8%	24.2%	29.8%
0.25 微米	0.5%	0.3%	0.5%
0.35 微米	15.1%	18.2%	21.8%

附註：

- (1) 包括 0.13 微米銅製程
- (2) 包括香港
- (3) 不包括中國

- 二零一零年第二季 0.13 微米及以下先進製程的晶圓付運佔總晶圓收入 55.8%。

產能*

晶圓廠／(晶圓尺寸)	二零一零年 第二季度	二零一零年 第一季度
上海廠(8吋)	84,000	84,000
北京廠(12吋)	46,125	46,800
天津廠(8吋)	33,000	34,300
每月晶圓代工生產總產能	163,125	165,100

附注：

*在期末的月產能折算成 8 吋晶圓的片數

付運及使用率

8 吋等值晶圓	二零一零年 第二季度	二零一零年 第一季度	二零零九年 第二季度
付運晶圓(包括銅製程)	496,766	455,010	341,261
使用率 ⁽¹⁾	94.3%	92.1%	75.4%

附注：

(1) 產能使用率按產出晶圓總額除以估計產能計算

- 二零一零年第二季折算成 8 吋晶圓的付運數量較二零一零年第一季的 455,010 片增加 9.0%至 496,766 片，較二零零九年第二季度的 341,261 片錄得年度升幅 45.6%。

詳細財務分析

毛利分析

以千美元計	二零一零年 第二季度	二零一零年 第一季度	季度比較	二零零九年 第二季度	年度比較
銷售成本	321,755	300,270	7.2%	280,319	14.8%
折舊	131,188	143,919	(8.8%)	146,763	(10.6%)
其他製造成本	189,620	155,119	22.2%	132,541	43.1%
股權報酬	947	1,232	(23.1%)	1,015	(6.7%)
毛利 (虧損)	59,387	51,454	15.4%	(12,897)	-
毛利率	15.6%	14.6%		(4.8%)	

- 二零一零年第二季的銷售成本與二零一零年第一季的3億零30萬元相比，上升7.2%至3億2千1百80萬元，主要是由於晶圓付運增加所致。
- 二零一零年第二季的毛利為5千9百40萬元，相對二零一零年第一季的5千1百50萬元及二零零九年第二季的負1億2千9百萬元。
- 二零一零年第二季的毛利率由二零一零年第一季的14.6%改善至15.6%，主要是由於產能使用率提高所致。

經營開支分析

以千美元計	二零一零年 第二季度	二零零九年 第一季度	季度比較	二零零九年 第二季度	年度比較
總經營開支	71,507	79,496	(10.0%)	81,606	(12.4%)
研究及開發	43,330	43,592	(0.6%)	48,450	(10.6%)
一般及行政	15,017	17,601	(14.7%)	17,196	(12.7%)
銷售及市場推廣	7,019	6,045	16.1%	6,905	1.7%
無形資產攤銷	6,686	6,886	(2.9%)	8,858	(24.5%)
資產處置損失(盈利)	(545)	233	-	197	-
長期資產減值損失	-	5,138	-	-	-

- 二零一零年第二季的總經營開支與二零一零年第一季的7千9百50萬元相比，錄得季度降幅10.0%至7千1百50萬元。季度降幅由於公司在二零一零年第一季發生的長期資產減值損失和本季內的一般及行政費用減少所致。
- 二零一零年第二季的研究及開發費用與二零一零年第一季的4千3百60萬元相比，錄得季度降幅0.6%至4千3百30萬元。
- 二零一零年第二季的一般及行政費用與二零一零年第一季的1千7百60萬元相比下降至1千5百萬元。
- 二零一零年第二季的銷售和市場推廣費用由二零一零年第一季的600萬元上升至700萬元，錄得季度升幅16.1%。

其他收入(支出)

以千美元計	二零一零年 第二季度	二零一零年 第一季度	季度比較	二零零九年 第二季度	年度比較
其他收入(支出)	101,812	(155,567)	-	(5,802)	-
利息收入	879	878	0.1%	635	38.4%
利息支出	(6,293)	(7,784)	(19.2%)	(8,386)	(25.0%)
所承諾授出的股份及認 股權證之公平價值變動	105,952	(146,561)	-	-	-
匯兌收益(虧損)	(3,164)	(3,241)	(2.4%)	219	-
其他，淨額	4,438	1,141	289.0%	1,730	156.5%

- 合併來自於經營性活動的匯兌損益，公司於二零一零年第二季整體錄得匯兌收益 220 萬元，相對二零一零年第一季錄得匯兌虧損 170 萬元。
- 二零一零年第二季其他非經營性收入為 1 億 1 百 80 萬元相較於二零一零年第一季其他非經營性費用 1 億 5 千 5 百 60 萬元，是由於股權及認購權證授予協定的公平價值的改變。

折舊及攤銷

- 二零一零年第二季的折舊及攤銷總額為 1 億 6 千 4 百 90 萬元，相較於二零一零年第一季的 1 億 7 千 4 百 70 萬元。

流動資金

以千美元計	二零一零年 第二季度	二零一零年 第一季度
現金及現金等價物	506,547	523,208
限制性現金	37,099	29,286
應收賬款	208,856	204,983
存貨	203,901	194,604
其他	53,410	53,687
流動資產總計	1,009,813	1,005,768
應付賬款	254,967	237,075
短期借款	357,387	333,795
長期借款的即期部份	275,294	204,442
其他	328,668	442,538
流動負債總計	1,216,316	1,217,850
現金比率	0.4x	0.4x
速動比率	0.6x	0.6x
流動比率	0.8x	0.8x

資本結構

以千美元計	二零一零年 第二季度	二零一零年 第一季度
現金及現金等價物	506,547	523,208
限制性現金	37,099	29,286
長期票據即期部分	54,164	59,163
長期票據	69,921	83,913
短期借款	357,387	333,795
長期借款的即期部份	275,294	204,442
長期借款	365,027	515,876
借款總計	997,708	1,054,113
股東權益	1,717,011	1,618,038
總債務股本比率	58.1%	65.1%

現金流量概要

以千美元計	二零一零年 第二季度	二零一零年 第一季度
來自於經營活動的現金淨額	167,495	153,316
來自於投資活動的現金淨額	(107,885)	(64,546)
來自於融資活動的現金淨額	(75,757)	(8,763)
匯率變動的影響	(514)	(262)
現金變動淨額	(16,661)	79,745

資本開支概要

- 二零一零年第二季資本開支為9千2百萬元。

近期公佈

- 中芯國際 65 納米技術成功進入批量生產 (2010-08-03)
- 海外監管公告(2010-07-21)
- 根據一般授權的新股配售已經完成(2010-07-15)
- 根據一般授權配售新股份;(1)大唐電信科技產業控股有限公司根據特別授權潛在認購新股份(2)解除大唐禁售限制之不獲豁免關連交易;台積電的優先認購權 (2010-07-08)
- 潛在不獲豁免關連交易(1)大唐潛在行使優先認購權及進一步認購股份及(2)解除大唐禁售限制; 台積電的優先認購權(2010-07-07)
- 年終報告根據 1934 年證券交易規則第 13 部分或 15(d)部分公佈 (2010-06-29)
- 二零一零年六月三日舉行之股東周年大會投票表決結果 (2010-06-03)
- 授出購股期權 (2010-05-25)
- 中芯國際和 Virage Logic 拓展夥伴關係至 65 納米低漏電工藝 (2010-05-24)
- 新思科技與中芯國際合作推出用於中芯 65 納米 LL 工藝技術的、獲得 USB 標誌認證的 **DesignWareUSB 2.0 nanoPHY (2010-05-14)**
- 暫停辦理股份過戶登記 (2010-05-12)
- 中芯截至二零一零年三月三十一日止三個月業績公佈 (2010-05-11)
- 2009 年年報 (2010-04-29)
- 通函(1)股東周年大會通告(2)重選董事(3)建議授出發行及購回股份之一般授權(4)建議根據二零零四年以股支薪獎勵計劃增加授出股權獎勵上限的特別授權及(5)建議修訂二零零四年以股支薪獎勵計劃 (2010-04-29)
- 通知信函及變更申請表格 (2010-04-29)
- 股東周年大會通告 (2010-04-29)
- 董事會會議日期通知 (2010-04-28)
- 二零零九年年度業績公佈 (2010-04-26)
- 中芯國際發布關於二零一零年第一季財務業績及二零零九年全年業績的最新資料 (2010-04-19)
- 董事會通過發佈年度業績報告日期通知 (2010-04-13)

上述公佈詳情請參閱中芯國際網站。

http://www.smics.com/website/cnVersion/Press_Center/newsRelease.ftl

中 芯 國 際 集 成 電 路 製 造 有 限 公 司

合 併 資 產 負 債 表

(以美元為單位,每股資料除外)

截至以下日期止

	二 零 一 零 年 六 月 三 十 日 (未 經 審 核)	二 零 一 零 年 三 月 三 十 一 日 (未 經 審 核)
資 產		
流 動 資 產 :		
現金及現金等價物	506,547,279	523,207,927
限定用途的現金	37,098,779	29,286,422
應收賬款, 已扣除撥備分別為二零一 零年六月三十日\$77,464,910元及二零一 零年三月三十一日\$96,111,136元	208,856,202	204,982,678
存貨	203,900,692	194,604,324
預付款項及其它流動資產	38,703,151	32,269,099
待售資產	9,167,973	13,244,958
遞延稅資產的即期部分	5,538,552	8,173,216
流 動 資 產 合 計	1,009,812,628	1,005,768,624
預付土地使用權	79,537,003	77,550,315
廠房及設備, 淨額	2,053,713,421	2,129,575,807
購入無形資產, 淨額	181,805,429	177,109,741
股權投資	9,244,259	9,392,886
其他長期預付款	143,033	214,588
遞延稅資產	109,849,717	98,651,547
資 產 合 計	3,444,105,490	3,498,263,508
負 債 及 股 東 權 益		
流 動 負 債 :		
應付帳款	254,967,307	237,075,087
預提費用及其它流動負債	113,563,072	116,494,349
短期借款	357,387,090	333,794,887
長期票據的即期部份	54,164,481	59,163,022
長期借款的即期部份	275,293,978	204,442,433
與訴訟和解相關的股份發行及認購權 證的協定	160,846,576	266,798,990
應付所得稅	93,799	81,310
流 動 負 債 合 計	1,216,316,303	1,217,850,078
長 期 負 債 :		
長期票據	69,920,879	83,912,660
長期借款	365,027,154	515,875,782

與特許權協定相關的長期應付款	2,418,587	4,837,526
其他長期負債	36,952,392	21,647,675
遞延稅負債	1,096,532	1,001,293
長期負債合計	475,415,544	627,274,936
負債合計	1,691,731,847	1,845,125,014
非控制權益	35,362,192	35,100,411
股東權益：		
普通股，面值 0.0004 元，法定股份為 50,000,000,000 股，於二零一零年六月三十日及二零一零年三月三十一日已發行及流通在外的股份分別為 22,480,259,472 股及 22,420,895,812 股。	8,992,104	8,968,359
額外繳入股本	3,507,140,466	3,503,714,048
累計其他綜合虧損	(1,161,906)	(648,316)
累計虧絀	(1,797,959,213)	(1,893,996,008)
股東權益合計	1,717,011,451	1,618,038,083
總負債，非控制權益及股東權益合計	3,444,105,490	3,498,263,508

中芯國際集成電路製造有限公司
 合併損益表
 (以美元為單位)

	截至以下日期止三個月	
	二零一零年 六月三十日 (未經審核)	二零一零年 三月三十一日 (未經審核)
銷售額	381,142,152	351,724,012
銷售成本	321,755,444	300,270,177
毛利	59,386,708	51,453,835
經營費用：		
研究及開發	43,329,679	43,592,355
一般及行政	15,017,028	17,601,140
銷售和市場推廣	7,019,386	6,045,489
購入無形資產攤銷	6,685,822	6,885,746
長期資產減值損失	-	5,137,925
來自廠房設備和其他固定資產的銷售 (盈利) 損失	(545,040)	233,053
經營費用總額	71,506,875	79,495,708
經營虧損	(12,120,167)	(28,041,873)
其他收入(支出)：		
利息收入	879,279	877,711
利息支出	(6,293,613)	(7,783,555)
所承諾授出的股份及認股權證之公平 價值變動	105,952,415	(146,561,217)
匯兌收益(損失)	(3,164,049)	(3,241,001)
其他,淨額	4,437,675	1,140,502
其他收入(支出), 淨額	101,811,707	(155,567,560)
所得稅前盈利(虧損)	89,691,540	(183,609,433)
所得稅利益	6,466,243	2,374,552
股權投資盈利(虧損)	140,793	(455,261)
淨盈利(虧損)	96,298,576	(181,690,142)
非控制權益持有人利息	(261,781)	(258,904)

中芯國際應佔盈利(虧損)	96,036,795	(181,949,046)
每股股份淨盈利(虧損)，基本	0.00	(0.01)
每股股份淨盈利(虧損)，攤薄	0.00	(0.01)
每股美國預托股份淨盈利(虧損)，基本	0.21	(0.41)
每股美國預托股份淨盈利(虧損)，攤薄	0.20	(0.41)
用作計算基本每股普通股盈利 (虧損)額的股份	22,480,222,740	22,396,835,456
用作計算攤薄每股普通股盈利 (虧損)額的股份	24,533,730,903	22,396,835,456

中 芯 國 際 集 成 電 路 製 造 有 限 公 司
合 併 現 金 流 量 表
(以美元為單位)

截至以下日期止三個月

	二零一零年 六月三十日 (未經審核)	二零一零年 三月三十一日 (未經審核)
經營活動:		
淨盈利(虧損)	96,298,576	(181,690,142)
淨虧損至經營活動所得(所耗)現金淨額對賬的調整:		
遞延稅	(8,468,268)	(4,326,783)
處置設備及其它長期資產損失	(545,040)	233,053
折舊及攤銷	155,371,401	164,246,614
購入無形資產攤銷	6,685,823	6,885,746
股權報酬	2,802,616	3,583,507
長期票據及與特許權協定相關的長期應付款的 非現金利息費用	1,120,440	1,129,497
股權投資虧損	(140,793)	455,261
長期資產減值損失	-	5,137,925
股權及認購權證授予協定的公平價值改變 備抵呆帳	(105,952,415) 315,823	146,561,217 (33,407)
營運資產及負債的變動:		
應收賬款，淨額	(4,189,347)	(658,725)
存貨	(9,296,368)	(899,129)
預付款及其它流動資產	(6,362,497)	(3,210,079)
應付賬款	19,833,793	8,714,410
預付土地使用權	(2,359,437)	222,141
預提費用及其它流動負債	7,063,135	6,973,898
應付所得稅	12,489	22,737
其他長期負債	15,304,717	(32,015)
經營活動所得現金淨額	167,494,648	153,315,726
投資活動:		
購入廠房、設備	(87,494,465)	(73,172,437)
政府授予購買廠房及設備所得款項	-	23,884,935
出售設備所得款項	352,200	5,045,012
出售待售資產所得款項	4,382,259	1,286,854

購買無形資產	(17,309,010)	(12,663,539)
購買短期投資	(3,000,000)	(2,668,692)
出售短期投資	2,997,000	2,668,692
轉換限定用途的現金	(7,812,357)	(8,926,238)
投資活動所耗現金淨額	(107,884,373)	(64,545,413)
融資活動:		
短期借款所得款項	128,442,986	171,264,418
償還短期借款支付的款項	(104,850,783)	(124,333,593)
長期借款所得款項	-	10,000,000
償還長期借款支付的款項	(79,997,083)	(46,118,964)
償還長期票據支付的款項	(20,000,000)	(20,000,000)
行使雇員購股權所得款項	647,547	425,392
融資活動所耗現金淨額	(75,757,333)	(8,762,747)
匯率變動的影響	(513,590)	(262,153)
現金及現金等價物增加(減少)淨額	(16,660,648)	79,745,413
現金及現金等價物— 期間開始	523,207,927	443,462,514
現金及現金等價物— 期間結束	506,547,279	523,207,927

於本公告日期，本公司董事分別為董事會主席兼獨立非執行董事江上舟先生、本公司總裁兼首席執行官兼執行董事王寧國博士、本公司非執行董事陳山枝先生、高永崗先生及周傑先生(及周傑先生的替任董事汪正綱先生)，以及本公司獨立非執行董事川西剛先生、陳立武先生。

承董事會命
中芯國際集成電路製造有限公司
王寧國
總裁，首席執行官
執行董事

中國上海

二零一零年八月十日

* 僅供識別